2026/11/4

EdgeTech+ 2026 出展のお知らせ
エッジ AI SoC「Di1」上で生成 AI（VLM/LLM）をクラウドなしで実行、パートナー各社と Physical AI 向けを含めた9つの最新デモを公開

～ロボット・ドローン・産業カメラへ広がる「Di1」エコシステムを一堂に～

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル（本社:東京都中野区、代表取締役会長兼社長 CEO:山本 達夫、東証グロース:3652、以下「DMP」）は、2026 年 11 月 18 日（水）から 20 日（金）までパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2026」（ブース番号：DB-12）に出展いたします。

DMP ブースでは、当社のエッジ AI SoC「Di1」を中核に、生成 AI（VLM/LLM）をクラウドに依存せず機器内で動かすデモや、ロボット・ドローン向けの空間認識、量産導入を見据えた産業用 AI カメラなど、パートナー企業との協業による9つのデモを展示します。「Di1」が、現場の機器の中で「見て・考えて・動く」Physical AI の社会実装を進めていく姿を実機でご覧いただけます。

■ 本展示のポイント

- **エッジで生成 AI が動く**：「Di1」ボード 1 枚・わずか 2GB の DRAM で、LLM を含む 8 つの AI モデルを同時に実行します。超小型エッジコンピュータでは、カメラ映像を約 0.9 秒で文章化して実況します。映像を外部に出さないため、プライバシー保護と通信コスト削減を両立します。
- **パートナーとともに広がる「Di1」エコシステム**：株式会社CRI・ミドルウェア、株式会社ティーツー・ラボラトリ、株式会社アルクスなどとの協業ソリューションを展示。CRI・ミドルウェアとの AI 映像圧縮デモは今回が初公開です。
- **量産・社会実装を見据えた提案**：GMSL2 カメラから AI 画像処理ユニットまでをターンキーで提供する産業用 AI カメラ、30mm 角の超小型エッジコンピュータ、橋梁点検などインフラ点検向けドローンのカメラ構成など、お客様の製品化を加速する提案をご紹介します。

■ 出展概要

展示会名	EdgeTech+ 2026
会期	2026 年 11 月 18 日（水）～20 日（金）10:00～17:00 （19 日（木）のみ 18:00 まで）
会場	パシフィコ横浜 展示ホール／アネックスホール
主催	一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）
DMP ブース番号	DB-12
入場料	無料（事前オンライン登録制）
事前登録サイト	https://www.jasa.or.jp/expo/

■ ブースイメージ



■出展コンセプト

「Di1 Everywhere ― エッジから広がる、パートナーとつくる Physical AI」

生成 AI・VLM（視覚言語モデル）の進化により、AI はクラウドから、ロボットやドローン、カメラといった“現場の機器”へと広がりつつあります。DMP は、低消費電力かつ高性能なエッジ AI 処理を実現する「Di1」を通じて、現場で動き、判断する AI の社会実装を推進しています。

今回の展示では、パートナー企業各社とのソリューションと、DMP 自社ソリューションを 3 つのテーマに分けてご紹介します。

■ 展示内容

テーマ A エッジ生成 AI ― 「Di1」の中で、AI が見て・考えて・話す

1. 画像認識 × LLM × 「Di1」

カメラに映る様子を AI が読み取り、「火曜日の夜 9 時 5 分、40～50 代くらいの男性が座っています」のような短い文章で報告するデモです。物体検出、顔の表情・年齢・性別の推定、姿勢推定、手のジェスチャー認識の結果を、4bit 量子化した大規模言語モデル Qwen2.5-1.5B が自然な文章にまとめます。横たわっている人を見つけると転倒の可能性を警告します。LLM を含む 8 つの AI モデルを、AI アクセラレータ「A3000」を搭載した「Di1」ボード 1 枚、わずか 2GB の DRAM で同時に動作させています。映像が外部に出ないため、見守りや店舗など、プライバシーへの配慮が必要な用途に適しています。

2. 「Di1」搭載小型エッジコンピュータ （協力：株式会社ティーツー・ラボラトリ）

株式会社ティーツー・ラボラトリとの協業にて、当社のエッジ向け SoC「Di1」を搭載した、フィジカル AI 向け「Di1 エッジコンピュータ」を展示します。

500 円硬貨とほぼ同等の 30mm 角という超小型サイズながら、物体検出と、映像を文章化する画像キャプション AI をボード内で実行します。来場者がカメラに近づくと、物体検出から、撮影映像を約 0.9 秒で文章化して実況するモードへ自動で切り替わります。推論はすべてボード内で完結し、クラウドを必要としません。

人流検知や忘れ物検知、障害物検知、不良検知など、現場機器への AI 組み込みや製品に合わせたカスタム設計のご相談も承ります。

3. 3D ディスプレイ + LLM （協力：株式会社アルクス）

エッジ AI×浮遊映像×ローカル LLM を組み合わせた、クラウドに依存しない対話型 AI システムです。「Di1」を搭載したインターフェイスボードがカメラ映像からリアルタイムに人物を検出し、それをきっかけに PC 上のローカル LLM が音声認識・応答生成・音声読み上げをオフラインで実行。ライト＆イメージ社の浮遊映像技術で空中に結像したキャラクターとの対話体験を実現しました。「見る・聞く・話す」をすべてローカルで完結させた、次世代ヒューマンインターフェイスです。

テーマ B　Physical AI ― ロボット・ドローンの「眼」と「判断」

4. vSLAM × 「Di1」

パートナー企業の技術協力を得て展示する、ロボットやドローン向けの空間認識デモです。「Di1」上で自己位置・姿勢をリアルタイムに推定するとともに、ステレオ深度推定により周囲の奥行きを算出し、3D マップを生成します。SLAM と深度推定をエッジ上で処理することで、ホスト側の処理負荷を抑えた空間認識システムを構成できます。屋内でのドローン点検や、倉庫・工場における AMR 搬送などへの応用を想定しています。会場では説明員が構成や技術の詳細をご説明します。

5. ロボット × VLM × 「Di1」

パートナー企業の技術協力を得て展示する、現場のカメラ映像をエッジ AI で解析し、異常検知から VLM による駆けつけ判断、4足歩行ロボットの自律移動までをつなぐデモです。「Di1」上のエッジ VLM とクラウド上の VLM が連携して状況を把握し、地図・経路を準リアルタイムに更新します。作業現場や倉庫での昏倒者への駆けつけや、荷崩れ区画への侵入防止などを想定しています。会場では説明員がシステム構成の詳細をご説明します。

6. インフラ点検ドローンの2つの眼

ドローンに必要な「飛ぶための眼（周囲監視）」と「ミッションを遂行する眼（点検用ペイロード）」の2つを、「Di1」で実現するコンセプトを、ドローン実機（Avilon 社製）とパネルでご紹介します。周囲の映像から距離や奥行きを把握して立体的に状況を捉え、点検用の撮像・画像処理で必要な情報を鮮明に記録します。橋梁などの社会インフラ点検の現場を想定し、実機とパネルでカメラ構成のイメージをご覧いただけます。

テーマ C　現場実装ソリューション ― 量産・導入を加速

7. 産業用 AI カメラソリューション

「Di1」を核に、GMSL2 カメラから AI 画像処理ユニットまでをワンストップで提供する「産業 AI カメラソリューション」を展示します。30mm 角の小型 C マウントカメラはヘッド分離が可能で、最大 15m の GMSL2 ケーブルにより設置場所を選びません。「Di1」内蔵の ISP/HDR で AI 認識に最適な画像に調整し、自社開発の AI モデルが入力画像のわずか 1%の領域の対象も検知します。カメラは 1.2W、AI 画像処理ユニットは平均 5.0W の低消費電力。サンプルソフトウェアを同梱したターンキー提供により、お客様の開発期間短縮と早期量産化に貢献します。マシンビジョン、公共セキュリティ、スマートパーキング、屋外害獣監視など幅広い用途に対応します。

8. 侵入物検出エッジ AI カメラ（参考出展）

「Di1 Development Kit」に侵入物検出 AI モデルを実装し、エリア内に侵入した人や荷物などの異物をリアルタイムに検知・表示します。測距センサーを用いず単眼カメラの画像のみで床以外の物体を異物として捉え、明るさや光源色が変化する環境でも安定して検出します。外部 PC やサーバを必要としません。

※構成・仕様は開発中のものであり、製品化の際には変更となる場合があります。

9. AI 映像圧縮 × 「Di1」（協力：株式会社CRI・ミドルウェア）【初公開】

株式会社CRI・ミドルウェアの動画圧縮ソリューション「CRI DietCoder Bridge」と「Di1」を組み合わせた、AI による映像圧縮デモを初めて公開します。「Di1」の AI が重要な対象物を判別し、その画質を維持したまま、それ以外の領域のデータ量を削減。ドライブレコーダーにおける車両ナンバーなど、必要な対象の視認性を保ちながら映像データを大幅に削減し、録画時間の延長と通信コストの削減に貢献します。今後は監視カメラやドローンなど、幅広い業界への展開を目指します。

■ 会社概要

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルは、GPU および AI 半導体の開発を手掛けるファブレス半導体企業です。独自の画像処理および AI 技術を基盤に、「Making the Image Intelligent」をパーパスに掲げ、エッジ AI 分野における革新的なソリューションを提供しています。

©2026 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル、DMP、DMP ロゴは株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
営業本部 TP 営業グループ
TEL:03-6454-0450
e-mail: info_06@dmprof.com
Web サイト: https://www.dmprof.com/jp/contact/